



重庆都梁科技企业孵化器



国家企业技术中心——重庆平伟实业股份有限公司 摄/蒋婷



梁平是“国家功率半导体封装高新技术产业化基地”，集成电路产业上下游产业链正不断延伸、完善

梁平 实施创新驱动发展战略 大力推动高质量发展

创新是引领发展的第一动力。党的十九大以来，梁平区不断完善科技创新体制机制，加快推进协同创新，切实增强自主创新能力和科技成果转化能力，创新主体集聚提质增速，高质量发展蓄势发力，为产业转型升级和经济社会发展提供了有力支撑。

目前，梁平被国家科技部认定为“国家功率半导体封装高新技术产业化基地”和“国家农业科技园区”，有国家高新技术企业64家、市级数字化车间9家，均列渝东北三峡库区城镇群和渝东南武陵山区城镇群第一位，并成功创建“两群”唯一的市级高新技术产业开发区，大力推动了创新高地建设和经济社会高质量发展。



位于重庆梁平国家农业科技园区的重庆数谷农场

今年初，梁平区2020年度创新驱动奖申报工作启动。截至目前，共有175户企业和3个人提交了申报材料。

党的十九大以来，梁平区共有300余户企业和20余名个人获得科技计划项目补助资金、创新奖扶资金7300万元，极大地推动了企业的创新驱动发展。

“优化创新大环境，营造创新好生态。”梁平区相关负责人介绍，梁平区始终把营造良好创新创业生态环境作为科技创新的坚实保障，持续推动创新创业氛围营造，不断加

强创新创业服务保障，一方面推进科技管理体制变革，另一方面建立科技创新投入机制。梁平推行科研项目经费“包干制”、科研项目结题备案制等改革，相继出台并完善《科技计划项目管理办法》《创新驱动奖扶办法》《专利资助奖励办法》《高新技术企业引育认定专项资金管理办法》等一系列科技创新政策，科技创新工作方向更加明确、重点更加聚焦。

与此同时，梁平加大财政资金引导力度，每年安排科技创新专项资金3000万元左右，支持企业发展

2020年9月，梁平都梁科技企业孵化器正式投入使用。这个孵化器现有17名专家顾问、19名创业导师，入驻的企业除了享受免除3年的租金外，生产性企业同等享受区里各项招商引资优惠政策，同时享受行政许可的代办、奖扶申报、政策咨询等多项免费服务。

目前，都梁科技企业孵化器已注册企业41家，今年1月被评定为市级综合性孵化器。

科技创新是产业发展的重要推动力。党的十九大以来，梁平区把提升科技创新能力作为创建高新区的重要标准，加快引育企业创新主体、建设特色创新平台、强化科技人才支撑、推进产学研协同创新，聚资源、强技术、壮主体、育人才、优环境，不断提升创新能力。

在加快引育创新主体上，梁平建立科技企业梯度培育库，实施科技企业成长工程，大力引进和培育科技企业。目前，入库重庆市科技企业206家、国家科技型中小企业49家，位列渝东北三峡库区城镇群第一位。同时国家和市级知识产权优势企业分别达到7家和15家，知识产权贯标企业35家。

5月14日，中铁建集成电路产业园项目在梁平区高新区开工建设。该项目聚焦“功率半导体封装”特色主体、“第三代半导体芯片及器件”和“高端封装”两翼，做强封装、做大应用，重点突破、补链成群，形成规模效益明显的集成电路产业集群区。这次参加集中签约的还有中铁建全绿色循环利用产业园、京东·梁平数字产业园等30个项目，协议引资133亿元。

2007年，重庆平伟实业股份有限公司（下称“平伟实业”）落户梁平工业园区，每年拿出销售收入的一定比例用于研发，提升科技创新能力。

“科技创新正助推梁平电子信息产业向千亿级产业集群迈进。”梁

优化创新环境

提升创新能力

发展高新产业

科技型企业和高新技术企业，建立科技创新基地、研发机构和科技服务机构，开展产学研合作及新产品研发，加强知识产权保护，推动科技成果转化转移转化。在推进科技金融改革上，梁平组建2000万元区种子基金为初创和小微科技型企业提供免息信用贷款；组建1亿元科技型企业知识价值信用贷款风险补偿基金为科技型企业提供贷款。

“380万元知识价值信用贷款助力我们走上了科技创新之路。”重庆融康彩印包装有限公司负责人介绍，在梁平区支持下，实现浸蜡纸箱

在加快引进创新人才上，梁平以需求为导向，以项目为纽带，聚力引进培育科技创新人才和团队。目前，汇集两院院士多名，引进培育高层次人才近50名，成立3个院士工作站（点），建立1个市级博士后科研工作站，认定重庆“英才计划”科技创业领军人才2名、创新创业示范团队5个、多名享受国务院特殊津贴专家。

在加速构建科技服务平台上，梁平推进规模以上工业企业研发机构逐步实现全覆盖，全区研发机构及分支机构近50个（其中，国家企业技术

工艺、吸塑工艺等自动化技术研发和产业化，纸箱防水防震抗变形方面的技术研发取得重大突破，填补了国内轻质重承纸品的技术空白。目前，公司研发并申请专利30多个，并成长获批为国家高新技术企业。

据统计，梁平区共有40家初创和小微科技型企业获得1800万元免息信用贷款；94家科技型企业得到1.5亿元价值信用贷款，引导叠加商业贷款达8000万元。据悉，梁平全社会研发投入强度位列渝东北三峡库区城镇群第一位。

去年4月，梁平区首个智能化、规模化科技服务综合体——高新区科创中心开工，主要建设科技企业孵化中心、高新展示中心、企业服务中心、数字经济研发中心、数字经济企业孵化器。作为企业科技创新的容器，科创中心建成运营后，将发挥孵化器和加速器作用，为入住企业提供金融、财务、法律、品牌、科技成果转化等系列专业服务，加速培育和壮大园区先进高端产业集群，助推高新区向数字化、智能化的园区提质转型升级发展。

“实施科技强区、人才强区行动，加快建设区域创新高地。”梁平区负责人介绍，下一步将深入推进以大数据智能化为引领的创新驱动发展战略，抓紧做实国家高新区、国家农高区、都梁新经济活力区等创新平台建设，高质量推动先进制造业、现代特色高效农业、新业态等产业创新，不断激发创新主体活力，加强创新人才引进培养使用，营造良好创新生态，推动全区高质量发展，确保“十四五”开好局起好步。

该负责人介绍，建设创新高地，要突出抓好制造业科技创新，大力培育引进创新主体，积极培育高成长性企业、独角兽企业；加快构建引进创新创业平台，推进都梁科技企业孵化器升格国家科技企业孵化器，推进落地建设“易智网梁平科技创新服务中心”科技成果转移转化平台，大力引进并支持企业自建或与高校院所共建科研机构、服务机构，推进建设50万平方米集成电路科技企业孵化器，加快创建国家“双创”示范基地。

同时，梁平启动实施高新技术研发专项，推进落实梁平区政府与市科技局科技会商议题，争取启动2000万元高新技术产业研发专项（含农业高新技术产业），力争全社会研发投入强度达到1%。全力打造国际IDM公司，服务并支持平伟实业5G射频器件与模组项目今年国庆节前试投产，争取并支持平伟实业功率半导体（含5G）设计公司落户梁平，全力支持平伟实业建成IDM公司，推动平伟实业建设集成电路产业学院和产业公共技术服务平台，并帮助济南三星电子5英寸GPP芯片制造项目开工建设。

在乡村振兴方面，梁平将选派市、区科技特派员100名，推进乡村振兴产业发展；加快建设好“重庆农科院梁平分院”“梁平区乡村振兴产业技术研究院有限责任公司”新型研发机构，推进水稻主导产业、梁平柚特色产业产生并转化更多科技成果，建设好国家农业科技园区，创建国家农高区。

此外，梁平还要持续营造良好创新生态，引进培育科技创新人才，深化产学研协同创新，修订并出台科技创新政策10条，加强科技创新服务指导，扩大科技型企业知识价值信用贷款规模和覆盖企业，加快建设区域创新高地，大力推动梁平高质量发展。

王琳琳 张常伟
图片除署名外由梁平区委宣传部提供

建设创新高地

中心1个、市级新型研发机构3个）、科技服务机构40多个。

在持续推进产学研协同创新上，梁平区推动全区30余家企业与市内外20余所高校、科研院所加强产学研合作，加速科技成果转化。

截至目前，梁平区承担40多项国家、市级重大专项和重点项目，认定和获批高新技术产品100多个、市级重大新产品几十个、国家地理标志商标、国家驰名商标10多个，荣获市政府科技进步一等奖2项、二等奖2项。

梁平豆制品制作工艺最复杂，产能较低、人工成本较高。2017年7月以来，陈永晶、王磊等人研发智能化设备全自动化数控豆腐机，让豆腐生产从小作坊走上了“自动化、智能化、规模化、标准化”生产道路，拥有发明专利20余项、实用新型专利100余项，建成第五代数字化豆腐生产车间。

据介绍，梁平还大力开展“机器换人”行动，围绕“互联网+”发展战略，成功培育了奇爽食品、百年张鸭子、上口佳等企业数字化车间9家、智能工厂1家。

今年2月，市政府批复设立重庆梁平高新技术产业开发区。现在，梁平正向创建国家级高新区迈进。

重庆梁平高新技术产业园区 摄/肖华



重庆梁平高新技术产业园区 摄/肖华